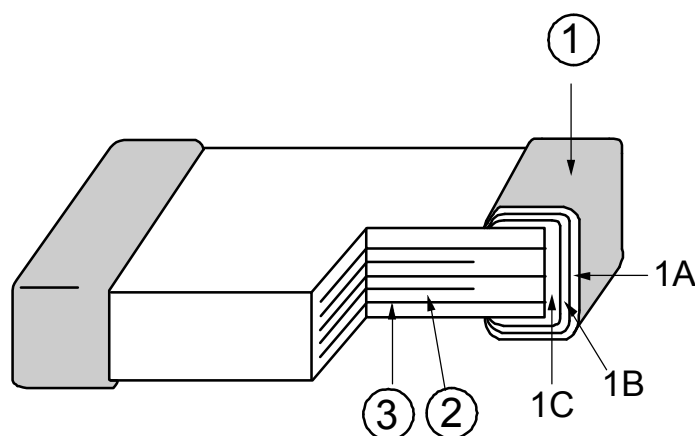


RF 高周波用低損失チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of RF High Frequency Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<GQM Series>

1.内部構造/Example of Structure



2.使用材料/Material

No.	名称/Name	主原料/Material
①	外部電極 Termination	
	1A めっき層 Plated layer	すず Tin
	1B めっき層 Plated layer	ニッケル Nickel
	1C 下地電極 Electrode	銅 Copper
②	誘電体素子 Dielectric layer	ジルコン酸カルシウム系 Ceramic
③	内部電極 Inner electrode	銅 Copper